

臺灣高等法院民事判決

107年度重上字第428號

上訴人 鈺緯科技開發股份有限公司

法定代理人 陳國森

訴訟代理人 陳佩貞律師

劉昱劭律師

被上訴人 友順科技股份有限公司

法定代理人 高耿輝

訴訟代理人 林翰緯律師

郭雨嵐律師

被上訴人 晶偉電子股份有限公司

法定代理人 劉子銘

共同

訴訟代理人 王怡惠律師

複代理人 江帝範律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國107年5月16日臺灣臺北地方法院105年度重訴字第689號第一審判決提起上訴，並為聲明之減縮，本院於108年9月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決關於駁回上訴人下列第二項之訴部分，暨該部分假執行之聲請，並訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。

二、被上訴人友順科技股份有限公司應給付上訴人新臺幣壹拾壹萬捌仟捌佰壹拾貳元、美金柒萬肆仟零玖拾柒點伍元、日幣玖佰貳拾參萬捌仟捌佰貳拾壹元，及自民國一百零五年五月十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

三、其餘上訴駁回。

四、第一、二審訴訟費用除確定部分外，由被上訴人友順科技股份有限公司負擔百分之四十七，餘由上訴人負擔。

五、本判決所命給付，於上訴人供擔保新臺幣壹佰柒拾玖萬元後得假執行，但被上訴人友順科技股份有限公司如以新臺幣伍佰參拾陸萬肆仟伍佰捌拾捌元或等值之銀行無記名可轉讓定

期存單為上訴人預供擔保後，得免為假執行。

事實及理由

一、程序方面：

按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意不得為之。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第446條第1項準用第255條第1項第3款定有明文。經查上訴人於原審聲明求為判決如附表一所示，原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並於本院減縮上訴聲明為如附表二所示，有民事辯論意旨狀(二)可稽（見本院卷二第234頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，則依前開規定，應予准許，合先敘明。

二、上訴人主張：型號LD1117AL-1.2V-A、批次QHTG之穩壓晶片（下稱系爭批次晶片）為被上訴人友順科技股份有限公司（下稱友順公司）所生產，其中2,500個（下稱系爭晶片）經上訴人於民國（下同）102年10月15日向被上訴人晶偉電子股份有限公司（下稱晶偉公司、以下與友順公司合稱為被上訴人）所購買後，於103年2、3月間經安裝於醫療用途等專業高階螢幕，再經上訴人出售予訴外人臺灣三菱電機股份有限公司（下稱三菱公司）、日商JVC Kenwood Corporation（下稱JVC公司）及馬來西亞商Plexus Manufacturing SDN BHD（下稱Plexus公司、以下合稱三菱公司等）。三菱公司等自103年6月起陸續反應有多台螢幕出現電壓不穩及故障等問題，嗣經確認該等螢幕均有系爭晶片之安裝。上訴人將上情轉知被上訴人，並將系爭晶片送請友順公司檢測及追查生產過程，友順公司因此出具三份客戶訴怨回答書（下稱系爭客訴回答書），確認系爭晶片有瑕疵，上訴人為此受有如附表三所示之瑕疵結果損害。友順公司業於103年8月20日出具保證書承諾賠償（下稱系爭保證書），故上訴人自得據以請求友順公司賠償損害。且上訴人亦得依民法第360條、第227條規定，請求晶偉公司賠償損害。爰求為判命：如附表一所示等語（原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起

上訴，並為聲明之減縮，減縮部分已告敗訴確定）。並上訴聲明：如附表二所示。

三、被上訴人則以：上訴人收貨及驗收時均未表示系爭晶片有瑕疵，且經上訴人全數使用及百分之百燒機測試均無問題，是晶偉公司出售予上訴人之系爭晶片，並無瑕疵。上訴人出售至日本之螢幕，為集合眾多電子零件加以組裝加工後之產品，因眾多電子元件和電路板間在整體設計匹配組合上，受外在因素如熱應力（加工過程）等影響，導致不良結果，並非因系爭晶片品質有瑕疵所致。上訴人遲至103年7月始向晶偉公司表示系爭晶片無反應，經被上訴人要求，上訴人始提供業已上錫使用過之系爭晶片做測試，但上訴人並未提供主機板一併測試。系爭客訴回答書雖表示，上訴人組裝電子元件時可能產生熱應力之問題，惟其僅係將「業已上錫使用過之系爭晶片」做失效可能性之推測，並非認定全新未使用之系爭晶片具有瑕疵，亦非自認。系爭晶片縱然有瑕疵，惟被上訴人估計有瑕疵件數之最大值僅為64件，並非全部2,500個晶片均有瑕疵。上訴人既未證明系爭晶片有瑕疵，是系爭保證書約定之賠償條件並未成就，上訴人自不得請求被上訴人賠償等語，資為抗辯。並答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執之事項：

(一)上訴人於102年10月15日向晶偉公司購買友順公司所生產之系爭晶片，上訴人於102年12月3日取得系爭晶片。

(二)系爭晶片焊錫加工在上訴人設計之螢幕電路板（主機板）上，經上訴人百分之百燒機測試後並無問題。

(三)友順公司分別於103年7月18日、8月7日、9月29日出具系爭客訴回答書。

(四)友順公司於103年8月20日出具系爭保證書予上訴人。

(五)晶偉公司於103年10月13日出貨全新1.2V晶片1萬個交由上訴人收受，上訴人於同年11月3日將與系爭晶片同型號1.2V之尚未上機使用晶片退貨予被上訴人。

五、兩造爭執要點為：(一)系爭晶片是否有瑕疵？數量為若干？
(二)上訴人得否依保證書之約定向友順公司請求損害賠償？(三)
上訴人得否依民法第360條、第227條第2項規定向晶偉公司
請求損害賠償？茲就兩造爭點及本院得心證理由分述如下：

(一)系爭晶片是否有瑕疵？數量為若干？

1.經查友順公司生產系爭批次晶片共12萬2,558個，並出售其中2,500個即系爭晶片予晶偉公司，晶偉公司再出售予上訴人後，上訴人將系爭晶片予以加工於主機板，復於主機板上組裝多種電子零件，施以多重加工後出售予三菱公司等人。嗣因三菱公司等人自103年6月起陸續向上訴人反映，系爭晶片有電壓輸出異常之瑕疵，上訴人乃轉知被上訴人，為兩造所不爭執。友順公司於103年7月18日、8月7日、9月29日先後受理晶偉公司所提出之客戶訴怨與系爭晶片中之2個、2個、3個，指稱該等晶片輸出電壓不足。經友順公司取庫存品與客戶退回品測試，並調查生產紀錄後，確認在進行最後1個料盒生產時，設備出現卡料問題，導致1條框架卡在軌道無法取出，由於無法在第一時間排除，因此通知該機台暫時停機生產，並告知負責人員將剩下最後1盒還未進行打線產品及已產出之產品皆放至氮氣櫃中存放。但經相關紀錄分析結果確認，產品因軌道卡料工程進行清機後，原卡料框架並無放入氮氣櫃中保存，在空氣中曝露時間過久，導致晶片表面氧化，因此晶片鋁墊與焊點焊球結合不完全，在經客戶端製程下因熱應力不匹配，間接影響打線點的原結合力形成打點接合性改變，最終造成焊球界面微裂，導致系爭晶片在進行單體驗證時，測試條件為輕載條件測試輸出正常，而加載測試輸出異常。依流程卡紀錄顯示，1條框架8排晶片數量共256個，卡料1條框架當時已打上線數量約3/4即192個晶片，未打數量約64個。由系爭晶片前後各5個批次生產記錄調查、及客戶端使用狀況並無異常等情，可確定風險批次為系爭晶片單一批次。友順公司並於103年8月15日、103年8月22日、103年10月7日分別提出系爭客訴回答書，有該等回答書影

本可稽（見原審卷一第35至44、206至215、222至230頁）。則據此足證系爭晶片中至少有64個具有「鋁墊與焊點焊球結合不完全而造成焊球界面微裂」之瑕疵（下稱系爭瑕疵）。被上訴人雖辯稱：系爭客訴回答書係針對已上錫的晶片所做成，並非就其產品為全面分析云云。惟查友順公司係就系爭晶片、以及同一生產批次之全部晶片生產紀錄檢測後，做成系爭客訴回答書，已如前述。且依MSE系統資料之產品過站時間顯示，系爭批次晶片有部分子批次生產時間為3至4天，遠超過一般正常生產時間為1至2天，因此友順公司始判定瑕疵原因為：「產品因軌道卡料工程進行清機後，原卡料框架並無放入氮氣櫃保存，導致在空氣中曝露時間過久導致晶片表面氧化」，有系爭客訴回答書影本可證（見原審卷一第42-1、212-1、228-1頁）。從而依晶片生產紀錄顯示其生產時間異常，足證系爭瑕疵原因為生產過程中卡料、氧化所致，與受檢測之晶片有無上錫並無關聯。被上訴人另辯稱：系爭晶片瑕疵可能是保存時受潮所致云云，惟查被上訴人就此並未舉證以實其說，是被上訴人此部分所辯，均屬無據。

2. 次查上訴人委任私立淡江大學電機系教授江正雄閱讀友順公司所出具之系爭客訴回答書後提出專家意見書，認為：(1) 晶片打線時，焊球與鋁墊間共金層之生成，會影響晶片在正常使用環境下之壽命。若共金層生成異常，將使晶片在正常使用環境下快速劣化，顯現出短路、斷路等異常情形。(2) 安裝有共金層生成異常晶片之終端電子產品，在晶片共金層裂縫尚未擴大到相當程度或斷裂前，無法從終端電子產品的電路測試或燒機等檢測中發現晶片之瑕疵等語，有該意見書可稽（見本院卷一第139至144頁）。江正雄復到庭具結陳稱：「鋁墊是IC（即晶片）對外連接的點，這個點需與IC腳座連起來，這個IC才能夠放在電路板上使用，如果焊球與鋁墊連接不完全，則IC裡面的訊號傳送就有問題，就無法運作……上述瑕疵於螢幕廠商進行燒機測試時，不完全可以檢測出來，因為連接一起時若很完整即形成共金層，但若沒有完全密合

，亦即只有幾個接觸點，這幾個接觸點，根據經驗，燒機時也許會有幾個會斷掉，但並非全部都會斷掉，但基本上是接的不好，將來使用時容易出問題，就是會脫落……我是從IC經過通電而使用時會發熱的情況做成此份意見書，因為IC跟鋁墊如沒有完全密合，會隨著溫度變化而劣化（可能會脫落）……通電時因鋁墊、焊球並未密合連接，所以在電學上會發生『電遷移』現象，會造成裂縫變大，最後會造成焊球與鋁墊會完全脫開……鋁墊與焊球沒有完全密合，就是共金層形成不良或異常……我是根據原審卷一第42-1、212-1、228-1頁（即系爭客訴回答書）之記載提出意見書，並未就系爭晶片做通電測試，因為我沒有看到系爭晶片。根據我的經驗，如果共金層形成很好，過錫爐時應不會產生裂縫，如果有受潮的話應該也不會產生裂縫，因為已經密接的很好，而且經過封裝，受潮不會影響。縱使受潮，也只有封裝外面的IC接腳會受影響，IC本身不受影響。完全沒有共金層時，焊球與鋁墊還是會有幾個接點，這幾個接點在燒機測試時不會完全都斷掉，所以在此情況下燒機測試還是會正常，只是無法持久性的使用。我沒有就系爭晶片的共金層與其他晶片做對比性測試，我只是看剛才3頁紀錄提出意見書。但是我看客戶訴願書的記載，上面有關於對比性的測試」等語，有準備程序筆錄可按（見本院卷二第109至110頁），則據此益證系爭晶片之鋁墊與焊點焊球結合不完全而有瑕疵。

3. 又查系爭客訴回答書為友順公司所製作，並已就特定晶片共7個檢測認定具有瑕疵，為兩造所不爭執。次查江正雄所提出之專家意見書固非鑑定文書，僅具私文書性質，惟江正雄既已到庭具結而為充分陳述，應認足為本院心證形成原因，屬於事實認定之自由心證主義範圍。再查江正雄就友順公司製作之系爭客訴回答書陳述意見，並非就系爭晶片加以鑑定，則被上訴人辯稱江正雄有偏頗之虞云云，即不足採。從而本院審酌友順公司既已就系爭晶片中之2個、2個、3個檢測認定有瑕疵，就檢測經過及結果為完整書面說明而做成系爭

客訴回答書，江正雄已閱讀該等書面資料，並到庭具結就系爭客訴回答書充分陳述，兩造復已就上開一切情狀充分陳述意見與辯論，足證系爭晶片因鋁墊與焊點焊球結合不完全而有瑕疵。上訴人此部分主張，應屬有據。被上訴人聲請再囑託私立東吳大學法律系李相臣教授鑑定，鑑定事項則為：「可否在無晶片驗證下，藉由3份報告書確定晶片有異常？如有異常會產生何種瑕疵？此種瑕疵於經過產品燒機測試24至48小時可否檢測出來？」云云，即無必要。被上訴人又辯稱：友順公司業以系爭保證書之出具，與上訴人締結證據契約，約定以「雙方共同驗證和確認」作為確認系爭瑕疵之方法，至於江正雄所出具之專家意見書並非雙方合意之證據方法，顯無證據能力云云。惟按所謂證據契約，係指當事人之間以合意就特定訴訟定其事實之證據方法。經查系爭保證書係由友順公司單方面書立並載明：「……針對貴司反饋我司品產品型號……期間若因材料品質不良，導致貴司客戶端處理費用之產生，經我司與貴司雙方共同驗證和確認後，係我司材料責任者我司願承擔賠償責任。」等語，有該保證書影本可稽（見原審卷一第45頁）。則據此足證系爭保證書之意旨，在於友順公司保證就系爭瑕疵損害與瑕疵結果損害負賠償責任，並非由上訴人與友順公司合意就本件訴訟定其事實之證據方法，亦無排除其他專家意見書之意，自非證據契約。是被上訴人此部分所辯，並不足採。

4. 再查上訴人於102年12月3日取得系爭晶片，交由訴外人上旺科技股份有限公司將系爭晶片焊錫加工在原設計之螢幕電路板上，再經上訴人為燒機測試無問題後，上訴人再將螢幕運送給三菱公司等，而三菱公司等遲至103年6月起方陸續反應螢幕有異常及故障之情形，固為兩造所不爭執。被上訴人雖辯稱：系爭晶片至少歷經焊錫於主機板上、主機板安裝於螢幕上等多次加工程序，且上訴人取得系爭晶片後已逾半年，三菱公司等使用後方反應螢幕有異常，因此不能證明系爭晶片係友順公司生產時即存有瑕疵，而可能係半年間歷

經加工、運送、使用後方產生之問題云云。惟查系爭晶片具有「鋁墊與焊點焊球結合不完全而造成焊球界面微裂」之瑕疵，業經友順公司所出具之系爭客訴回答書所載明，並經江正雄到庭具結而為充分意見陳述，已如前述。從而被上訴人既辯稱系爭瑕疵並非於友順公司生產時所致，則被上訴人就此即應舉證以實其說，亦即被上訴人應證明系爭瑕疵係因上訴人加工、運送、或三菱公司等使用不當等其他因素所致。次查證人即友順公司所屬工程師王啟任固於原審到庭結證稱：伊工作內容為產品檢驗及客戶應用處理，伊有參與系爭客訴回答書之製作，上訴人將上錫使用過的系爭晶片退回給友順公司做檢測，檢測後認為晶片的輸出電壓偏低，分析此異常現象的原因可能係縫隙的問題，而縫隙的產生有可能是上訴人在做加熱或IR時熱應力所造成，也可能是拆卸時施力不當，當然還可能有其他原因，而系爭客訴回答書判定造成客退品之問題有3種可能的原因，主要是針對上訴人及友順公司這兩端可能的原因先做說明，其中一個可能原因即是熱應力，而伊去反查生產紀錄，發現生產時有卡料的現象，所以也記載在系爭客訴回答書上，系爭客訴回答書是針對客退品問題點去做推測，並非指友順公司生產之系爭晶片有瑕疵等語，有言詞辯論筆錄可稽（見原審卷二第48-1至50頁）。惟查王啟任既證稱其於參與系爭客訴回答書之製作時，查閱生產紀錄而發現生產時有卡料現象，此為客觀事實，則據此足證系爭瑕疵確實於友順公司生產時所造成。至於王啟任雖又推測系爭瑕疵之其他發生原因，惟王啟任並未提出任何證據加以證明，純為主觀推測或卸責之詞，且被上訴人亦未舉證證明系爭瑕疵係因上訴人加熱或IR時熱應力、拆卸時施力不當、或其他原因如三菱公司等使用不當所致，故王啟任關於「可能是熱應力」之證言即不足以為有利於被上訴人之認定。是被上訴人此部分所辯，並不足採。

5.另查依系爭客訴回答書所載，系爭晶片生產過程中，發生卡料、缺氧之晶片數量固然僅約為64個，但系爭晶片之外觀全

部相同，無法辨別彼此，故確認系爭晶片全部為瑕疵風險批次，為兩造所不爭執。從而既已確定部分晶片有瑕疵，則為確保系爭晶片所經安裝之醫療用螢幕符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，上訴人主張必須更換安裝系爭晶片之全部醫療用螢幕，因此系爭瑕疵晶片之數量應以2,500個計算等語，應屬有據。被上訴人辯稱：所謂「風險」係事件發生與否具不確定性，不能以「風險批次」即推定系爭晶片全部有瑕疵，且縱有瑕疵，其數量亦僅為64個云云，並不足採。此外證人盧俊宇即上訴人所屬研發硬體經理於原審到庭結證稱：「因為晶片產生的縫隙，我們無法在螢幕的出貨檢驗即時看到問題，因為縫隙會慢慢地越來越大，導致晶片漸漸異常，這就是我們所謂風險……因為縫隙慢慢變大，所能承受的電流越來越小……晶片原本需要穩定的電流去正常工作，但電流越來越小，晶片就會慢慢失效，在晶片失效的過程中，螢幕就會有雜訊產生，螢幕不會立刻沒有畫面……如果電流越來越小，內部的分壓電阻就會越來越大，晶片就會越來越燙，久了就會燒燬……由閎康公司及三菱公司的報告，及系爭客訴回答書，都是指向生產製程中產生縫隙，縫隙會慢慢越來越大，而不是即時發生……我們可以想想在加護病房使用此螢幕，當病人在危急時，螢幕突然消失沒有畫面，會造成病人可能的死亡，這是我們不可預估的風險」等語，有言詞辯論筆錄可按（見原審卷二第4至5頁），則據此足證上訴人於受領系爭晶片時，無從即時檢查並發現系爭瑕疵。是被上訴人所辯，均不足採。

(二)上訴人得否依保證書之約定向友順公司請求損害賠償？

1.經查友順公司於103年8月20日出具系爭保證書予上訴人並載明：「Letter of Guarantee：友順科技股份有限公司特此提出保證……針對貴司反饋我司品產品型號：LD1117AL-1. 2V-A-Q D/C：QHTG(2.5K PCS)。期間若因材料品質不良，導致貴司客戶端處理費用之產生，經我司與貴司雙方共同驗證和確認後，係我司材料責任者我司願承擔賠償責任。」等語

，有該保證書影本可稽（見原審卷一第45頁）。次查友順公司已出具系爭客訴回答書，與上訴人共同驗證及確認系爭瑕疵發生原因，在於系爭晶片於製程中發生卡料、氧化現象，以致於共金層生成不良，進而造成電壓不穩之問題，已如前述，則據此足證上訴人與友順公司已共同驗證及確認友順公司所生產之系爭晶片有瑕疵。再查友順公司既係保證賠償上訴人關於「客戶端處理費用之產生」，足證上訴人得請求損害賠償之範圍，包括系爭瑕疵本身所造成之損害、以及因瑕疵結果所生之損害。是上訴人此部分主張，即屬有據。

2. 附表三編號一部分：

上訴人主張其業已賠償JVC公司重工費用美金5萬6,365元、重工零件費用美金1萬7,732.5元，並有如附表三編號一所示單據影本可稽。友順公司雖辯稱：JVC公司拆解者為前框、後殼、配件等，均與系爭晶片無關，且依商業經濟行為，就瑕疵部分進行維修即可，JVC公司拆解上訴人之螢幕致不屬於系爭晶片之原物料受損，應屬上訴人與JVC公司間之商業策略，與系爭瑕疵無因果關係；折讓單據為上訴人自行製作，未經JVC公司確認云云。經查就已組裝好並完成包裝的螢幕，一旦予以拆卸並更換螢幕內主機板上的系爭晶片，必然損及部分相關原物料即螢幕各部位框架、配件、面板、外箱等，此為當然物理作用。從而JVC公司維修因系爭晶片瑕疵所造成之螢幕瑕疵時，當然必須拆卸螢幕，因此受有相關原物料耗損之損害，與系爭瑕疵之間具有相當因果關係，屬於瑕疵結果損害。是上訴人此部分請求，即屬有據。友順公司所辯，並不足採。

3. 附表三編號二部分：

上訴人主張賠償三菱公司重工費用日幣923萬8,821元，並有如附表三編號二所示單據影本可稽。友順公司雖辯稱：三菱公司所出具之聲明書欠缺三菱公司核章，亦無三菱公司授權文件；且該公證書僅證明聲明書簽名之真實性，無法證明聲明書內容之真正云云。經查三菱公司107年9月13日聲明書已

載明獲得上訴人賠償日幣923萬8,821元，且該聲明書業經日本長崎地方法務局公證人公證，該公證書並經我國駐大阪經濟文化辦事處認證，有該聲明書暨中譯文影本可證（見本院卷一第183至188頁）。次查上訴人當時係經多次協商，始將賠償費用自日幣1,201萬7,453元減少為日幣923萬8,821元，有電子郵件暨中譯文影本可憑（見本院卷一第181至182頁）。且三菱公司之上開聲明書所示內容，亦與上訴人提出之會計傳票及支付憑證影本所示數額相符（見本院卷一第189至192頁）。則據此足證上訴人因賠償三菱公司重工費用所受損害，與系爭瑕疵之間具有相當因果關係，屬於瑕疵結果損害。是上訴人此部分請求，即屬有據。友順公司所辯，並不足採。

4. 附表三編號三部分：

上訴人主張支出廠內重工費用新臺幣（下同）26萬0,568元，固有重工明細及維修追蹤表影本可稽（見原審卷一第276至294頁）。友順公司則辯稱：上訴人無法提出重工後晶片，且重工明細表為上訴人所製作，與維修追蹤表不符，維修追蹤表中有105年維修者，應不實在等語。經查上訴人將相關電路板及螢幕重工後即再出貨，已拆卸者則為廢料，自無從提出重工後晶片。次查上訴人確有實施重工，有維修追蹤表影本可證（見原審卷一第276至294頁），且依該等追蹤表所示重工時間為2,134分鐘，每分鐘以18元計算，總計為3萬8,412元（計算式：18元/分鐘×2,134分鐘=38,412元），為上訴人所自陳。再查入廠日期105年1月19日之重工費用1,080元（計算式：18元/分鐘×40分鐘維修+20分鐘檢驗V=1,080元），有維修追蹤表單號15017影本可憑（見原審卷一第289-1頁），顯然與系爭瑕疵無因果關係，應予剔除，友順公司此部分所辯，應為可採。從而上訴人因廠內重工費用所受損害應為3萬7,332元（38,412-1,080=37,332），與系爭瑕疵之間具有相當因果關係，屬於瑕疵結果損害。是上訴人此部分請求，即屬有據。友順公司辯稱上訴人未受

01 損害云云，並不足採。

02 5.附表三編號四部分：

03 上訴人主張另行委任訴外人閎康科技股份有限公司（下稱閎
04 康公司）檢測系爭晶片而支出費用8萬1,480元，有如附表三
05 編號四所示文書影本可稽。友順公司雖辯稱：閎康公司分析
06 報告（下稱系爭報告）已載明非經閎康公司同意不得用於訴
07 訟，故該報告無證據能力，且系爭報告無記載檢驗物品之型
08 號、批次，不足為證云云。經查系爭報告確實為閎康公司所
09 製作，有系爭報告與閎康公司106年6月7日函文可證（見原
10 審卷一第191至201-1頁、原審卷二第28頁），自有證據能力
11 。至於閎康公司聲稱系爭報告「不得用於訴訟案件」云云，
12 並無拘束法院發現真實之效力，亦無礙於其形式真正。次查
13 系爭報告雖未載明檢驗晶片之型號與批次，但上訴人於103
14 年8月22日將系爭報告提供予三菱公司之電子郵件，其主旨
15 即載明為關於型號TSD-T212-F N螢幕之報告（見原審卷一第
16 191頁），核與三菱公司於103年6月27日反應瑕疵之電子郵
17 件記載相符（見原審卷一第190-1頁）。且上訴人於103年7
18 月15日向三菱公司說明瑕疵螢幕數量之電子郵件，其主旨亦
19 載明瑕疵螢幕型號為TSD-T212-FN，內容則為說明使用系爭
20 批次晶片製造之TSD-T212-FN螢幕數量（見原審卷一第202頁
21 ）。兩造於105年2月間商談賠償數額時，被上訴人以電子郵
22 件向上訴人表示：「IC分析費用，當初UTC（即友順公司）
23 已提出真正原因，客戶（指三菱公司）要確認有問題那應該
24 是客戶的問題，費用不可以算UTC的」（見原審卷二第71至
25 73-1頁），足證被上訴人知悉上訴人委任閎康公司檢測系爭
26 晶片瑕疵並已提出系爭報告，上訴人確實委任閎康公司檢測
27 系爭瑕疵晶片。從而據此足證上訴人支出檢測費用8萬1,480
28 元，與系爭瑕疵有相當因果關係，屬於瑕疵結果損害。是上
29 訴人此部分請求，即屬有據。友順公司所辯，並不足採。

30 6.附表三編號五部分：

31 上訴人主張支出差旅費新臺幣19萬0,727元、美金3,240元、

日幣 37萬 6,652元，固有如附表三編號五所示單據影本可稽。惟查 104 年 2 月 16 日出差工作報告表記載為「例行性拜訪」（見原審卷一第 63-1 頁），104 年 2 月 2 日出差工作報告表記載為「參加學會」（見原審卷一第 64 頁），103 年 9 月 12 日出差工作報告表記載為「品質問題、採購價格、NRE 產品費用、新產品介紹」（見原審卷一第 64-1 頁），且上訴人之法定代理人陳國森於原審到庭結證稱：「去日本拜訪不會只有做一件事情，主要是修補我們公司和 JVC 的關係，其他是附帶的」等語，有言詞辯論筆錄可證（見原審卷二第 48-1 頁）。則據此足證上訴人所屬人員顯非專為處理系爭晶片瑕疵問題而出差，因此上訴人所支出差旅費用，與系爭瑕疵之間並無相當因果關係，並非系爭瑕疵損害或瑕疵結果損害。是上訴人此部分請求，即不可採。友順公司辯稱該等費用與系爭瑕疵無關等語，應屬有據。

7. 從而上訴人依系爭保證書約定，得請求友順公司賠償損害如附表三編號一、二、三、四所示共美金 7 萬 4,097.5 元（計算式： $56,365 + 17,732.5 = 74,097.5$ ）、日幣 923 萬 8,821 元、新臺幣 11 萬 8,812 元（計算式： $37,332 + 81,480 = 118,812$ ）。

(三) 上訴人得否依民法第 360 條、第 227 條第 2 項規定向晶偉公司請求損害賠償？

1. 按買賣之物，缺少出賣人所保證之品質者，買受人得不解除契約或請求減少價金，而請求不履行之損害賠償；出賣人故意不告知物之瑕疵者亦同，民法第 360 條固有明文。該條係就約定物之瑕疵擔保責任所為之特別規定，固須出賣人就買賣標的物曾與買受人約定，保證有某種品質，而其物又欠缺其所保證品質時，買受人始得依該條規定向出賣人請求不履行之損害賠償。出賣人與買受人間有無此項保證品質之特約，應以契約內容及當事人立約當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準。至於約定之方式，不問係由出賣人主動提出保證，或由買受人要求其品質，而出賣人予以同意，均無不可。經查上訴人向晶偉公司採購系爭晶片之採購單上記

載採購之品名為「LD1117AL-1.2V SOT-223」，固有採購單影本可稽（見原審卷一第8頁）。惟查該等品名之記載，僅足以證明上訴人指示晶偉公司給付之標的物，並特定給付物之種類與品質，但不足以證明晶偉公司曾與上訴人約定，保證上訴人於醫療用螢幕上使用之系爭晶片具備一定品質。從而上訴人主張：晶偉公司保證系爭晶片之電壓規格為1.2V，惟系爭晶片卻有電壓輸出異常之瑕疵，明顯悖於其保證之品質云云，即不足採。此外上訴人並未證明曾告知晶偉公司：「系爭晶片將使用於特定目的即醫療用螢幕，如欠缺保證之品質，以致於上訴人應對第三人負損害賠償責任時，晶偉公司應賠償上訴人之損害」，亦未證明晶偉公司故意不告知瑕疵，則上訴人主張依民法第360條規定，請求晶偉公司賠償損害云云，即屬無據。

2. 按出賣人就其交付之買賣標的物有應負擔擔保責任之瑕疵，而其瑕疵係於契約成立後始發生，且因可歸責於出賣人之事由所致者，則出賣人除負物之瑕疵擔保責任外，同時構成不完全給付之債務不履行責任。又種類之債在特定時，即存有瑕疵者，出賣人除應負物之瑕疵擔保責任外，並應負不完全給付之債務不履行責任。經查系爭晶片於友順公司生產過程中發生瑕疵，上訴人嗣後向友順公司買受並受領系爭晶片之交付時，系爭瑕疵固然即已存在，已如前述。惟查系爭瑕疵既係因友順公司於製程中發生卡料、氧化現象，以致於共金層生成不良，進而造成電壓不穩所致，亦如前述，則晶偉公司就系爭瑕疵之發生，既無可歸責之事由，即無不完全給付可言。上訴人雖主張：晶偉公司為友順公司於臺灣區之代理商，與友順公司有長期且極緊密之合作關係，本件瑕疵事故發生後，晶偉公司亦皆參與上訴人與友順公司之檢討會議，共同檢討友順公司晶片製程改善計畫，非僅單純買入賣出轉手交易，晶偉公司就系爭晶片之生產及品質顯有瞭解及掌握之可能，卻未盡品質把關之責任，仍交付系爭瑕疵晶片予上訴人，造成上訴人損害，其縱無故意，亦至少有過失，而屬可

01 歸責，應依民法第227條第2項規定對上訴人負損害賠償責任
02 云云。惟查據此僅足以證明被上訴人間關係密切，但不足以
03 證明晶偉公司就系爭瑕疵之發生有可歸責之事由。是上訴人
04 主張依民法第227條第2項規定，請求晶偉公司賠償損害云云
05 亦屬無據。

06 六、綜上所述，上訴人依系爭保證書之約定，請求友順公司給付
07 新臺幣11萬8,812元、美金7萬4,097.5元及日幣923萬8,821
08 元，及自105年5月18日起（上訴人於105年5月9日定期7日催
09 告友順公司給付，友順公司於105年5月10日收受送達，見原
10 審卷一第48頁之送達回執）起至清償日止，按年息5%計算之
11 利息，至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為屬正當，
12 應予准許。逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。上訴人
13 另依民法第360條、第227條第2項規定，請求晶偉公司給付
14 新臺幣53萬2,775元、美金7萬7,337.5元及日幣961萬5,473
15 元本息，並非正當，不應准許。上開應准許部分，原審為上
16 訴人此部分敗訴判決及駁回假執行之聲請，尚有未洽，上訴
17 人之上訴為有理由，應由本院予以廢棄改判如主文第二項所
18 示。上訴人與友順公司就上訴人勝訴部分，均陳明願供擔保
19 請准為假執行或免為假執行之宣告，經核均無不合，爰酌定
20 相當擔保金額分別准許之。至於上開不應准許部分，上訴人
21 之請求，並非正當。原審為上訴人敗訴之判決及駁回假執行
22 之聲請，理由雖有不同，結論並無不合。上訴人就此部分上
23 訴求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

24 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法，核與判決
25 結果不生影響，毋庸逐一論列，併此敘明。

26 八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴
27 訟法第449條第1項、第2項、第450條、第79條、第85條第1
28 項但書、第463條、第390條第2項、第392條第2項，判決如
29 主文。

30 中 華 民 國 108 年 10 月 15 日
31 民事第十庭

審判長法官黃嘉烈
法官高明德
法官邱琦

正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中華民國108年10月15日
書記官廖月女

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

附表一：上訴人於原審訴之聲明

編號	
一	被告應各給付原告新臺幣52萬0,258元、美金7萬7,337.5元及日幣1,239萬4,105元暨自105年5月17日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，但其中如有一被告為給付時，其餘被告就已給付部分，免其責任，
二	願以現金或等值之銀行無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。

附表二：上訴人於本院減縮後之上訴聲明

編號	
一	原判決關於駁回上訴人後開第二項請求及其假執行聲請，暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

(續上頁)

二	上開廢棄部分，被上訴人應各給付上訴人新臺幣53萬2,775元、美金7萬7,337.5元及日幣961萬5,473元暨自民國105年5月17日起至清償日止按年息5%計算之利息，但其中如有一被上訴人為給付時，其餘被上訴人就已給付部分，免其責任。
三	上訴人願以現金或等值之銀行無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
四	第一、二審訴訟費用除確定部分外，均由被上訴人負擔。

附表三：上訴人主張之損害

編號	項目	上訴人主張之金額	原因	證據	本院認定之金額
一	JVC公司 重工費用	(1)美金5萬6,365元	重工求償費用	(1)請求單據影本（原審卷一第50至53-1頁） (2)會計傳票影本（本院卷一第165至180頁）	美金5萬6,365元
		(2)美金1萬7,732.5元	重工零件費用	(1)減縮後之JVC公司重工零件明細及單據（原審卷一第165至168-1頁）	美金1萬7,732.5元
二	三菱公司 重工費用	日幣923萬8,821元	自行重工及處理 瑕疵等費用	(1)三菱公司2018年9月13日聲明書影本暨中譯文（本院卷一第183至188頁） (2)會計傳票及支付憑證影本（本院卷一第189至192頁）	日幣923萬8,821元
三	上訴人 重工費用	新臺幣26萬0,568元	增加上訴人場內 重工成本之損害	(1)重工明細及維修追蹤表影本（原審卷一第276至294頁）	新臺幣3萬7,332元
四	上訴人 檢測費用	新臺幣8萬1,480元	晶片瑕疵檢測費用	(1)上訴人於103年8月22日所發之電子郵件暨附件閎康公司晶片檢測報告影本（原審卷一第191至201-1頁） (2)上訴人於105年2月19日所發之電子郵件（原審卷二第71至73-1頁）	新臺幣8萬1,480元
五	上訴人 差旅費	(1)新臺幣19萬0,727元 (2)美金3,240元 (3)日幣37萬6,652元	上訴人員工支出 之差旅費	(1)差旅費明細及單據影本（原審卷一第62至66-1頁）	零。